

# 适用于工业级领域的大功率器件

## IEGT / SiC相关器件

### 产品概述

东芝凭借高耐压·高节温的IEGT\*1及SiC\*2材料的应用，在新能源发电·输配电·变频应用整个产业领域，为实现高效·节能·轻小型的电力转换设备做出贡献。

### 方案特点

POINT

**1**

#### 广范围的耐压等级

- 击穿电压从1700V到6500V产品线
- 可以减少电力转换设备中直串器件的数量
- 部件数量的减少有助于提高设备的安全可靠性

POINT

**2**

#### 应用新材料实现低损耗

- SiC-SBD（碳化硅肖特基二极管）和IEGT组成混合型器件
- 全SiC器件低导通电阻和低开关损耗特性，可以使整个设备系统更高效节能，更轻小型化

POINT

**3**

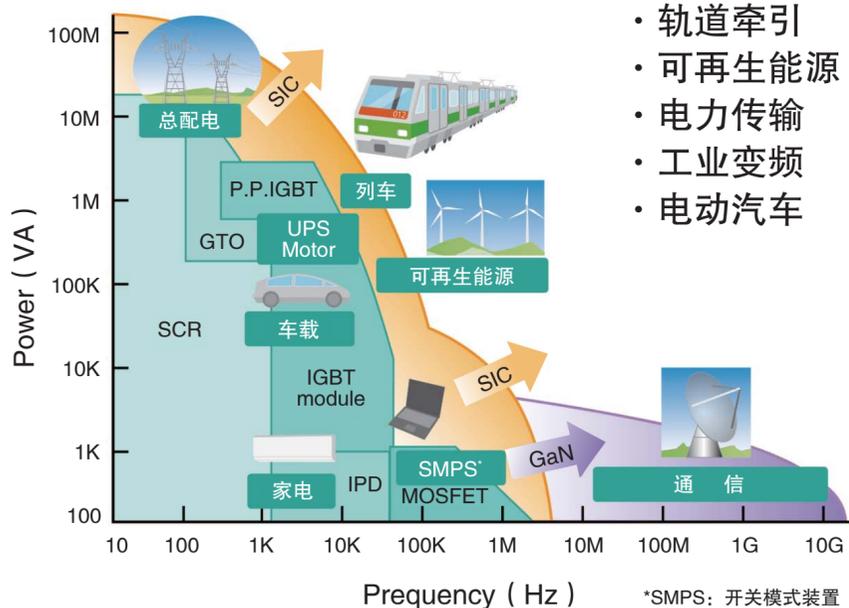
#### 针对不同应用提供合适的器件封装

- 提供2种封装
- 高可靠性，可双面冷却的“压接式封装IEGT（PPI）”
- 螺纹连接，方便拆卸处理的“塑料模块式封装IEGT（PMI）”

\*1 IEGT: Injection Enhanced Gate Transistor (栅极注入增强型晶体管-东芝专利名称)

\*2 SiC: 碳化硅

### 应用领域及目标市场



### 封装

#### ◆ 压接式封装IEGT（PPI）



· ST750GXH24  
(750A-4500V)

#### ◆ 塑料模块封装IEGT（PMI）



· MG1500FXF1US62  
(1500A-3300V 1in1)

